

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
2	140	Shiba and Masataka	JPO; DERWENT	2002/10/18 10:48

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-269294

(43)公開日 平成9年(1997)10月14日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

G 0 1 N 21/84

識別記号

庁内整理番号

F I

G 0 1 N 21/84

技術表示箇所

Z

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平8-80200

(22)出願日 平成8年(1996)4月2日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(71)出願人 000233480

日立電子エンジニアリング株式会社

東京都渋谷区東3丁目16番3号

(72)発明者 芝 正孝

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式

会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 渡辺 健二

東京都小平市上水本町五丁目20番1号株式

会社日立製作所半導体事業部内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

最終頁に続く

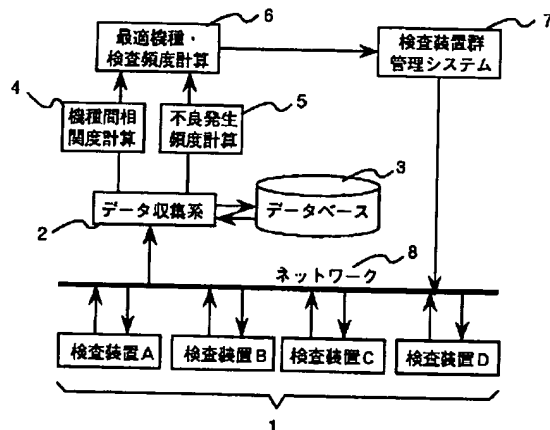
(54)【発明の名称】 電子部品の製造方法

(57)【要約】

【課題】半導体ウエハ等製造における、最適検査装置、検査頻度の設定を行う。

【解決手段】検査装置群1の各検査装置は、ネットワーク8に接続され、検査終了後に結果をデータ収集系2に転送する。ある特定の不良モードが確認された場合、特定工程から選択した同一のウエハを検査装置群1の機種の変化する検査装置により検査したデータを収集し解析することにより、機種間の相関度を計算をする(4)。一方、同一工程の不良発生経過を分析することにより、平均的な不良発生頻度を求めることができる(5)。そして、機種間相関度計算処理と不良発生頻度計算処理の計算結果をもとに、最適な検査装置と検査頻度を逐次求め(6)、検査装置群管理システム7を介して、検査装置群1へのウエハの投入方法等を指示する。これにより電子部品の製造において、適用検査装置、検査頻度等、複雑な検査条件を容易に設定できると共に、総合損失期待値最小という操作を行うことにより、検査の経済効率を飛躍的に向上させることができる。

図1



CLIPPEDIMAGE= JP409269294A

PAT-NO: JP409269294A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09269294 A

TITLE: MANUFACTURE OF ELECTRONIC PART

PUBN-DATE: October 14, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHIBA, MASATAKA

WATANABE, KENJI

HAMADA, TOSHIMITSU

ISHIKAWA, SEIJI

GO, NAOKI

YANAI, TOSHIAKI

WATANABE, TETSUYA

JINGU, TAKAHIRO

INT-CL (IPC): G01N021/84

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To establish an optimum examination device and a frequency of examination in manufacture of semiconductor wafers and the like.

SOLUTION: Each examination device of a group 1 of examination devices is connected to a network 8, and after an examination is finished, the result is transferred to a data gathering system 2. Where a predetermined badness mode is confirmed, same wafers selected from a predetermined process are examined by examination devices of different type of the group of examinations devices 1 and the data are gathered and analyzed to calculate the degree of correlation between types of device 4. On the other hand, a mean frequency of occurrence

of badness may be obtained by analyzing the badness occurrence progress in the same process 5. Then, an optimum examination device and a frequency of examination are successively obtained on the basis of the results of calculations of calculation processing of the degree of correlation between types of device and of calculation processing of frequency of occurrence of badness 6, and the method of introduction of wafers into the group of examination devices 1 or the like is indicated through a system 7 managing the group of examination devices. It is thus possible to easily establish complicated conditions of examination such as an applied examination device, a frequency of examination and the like in manufacture of electronic parts as well as dramatically improve the economic efficiency of examination by performing an expected value minimization of the overall loss.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

----- KWIC -----

Inventor Name - INNI:

SHIBA, MASATAKA

Inventor Name ( Derived ) - INZZ:

SHIBA, MASATAKA